

## HP-600A (S) 型精密自动划片机

该机主要用于集成电路、发光二极管、铌酸锂、压电陶瓷、石英、砷化镓、蓝宝石、氧化铝、氧化铁、玻璃等材料的划切加工。

### 主要技术特点：

1. 采用 CCD 监视对准系统，全中文人机界面，实时提示，操作方便。
2. 多文件参数化模式控制，适应多种材料、不同模式划切
3. 空气静压主轴，有三种直径刀盘（标准配置），刀具利用率更高。
4. 独特的  $\theta$  工作台，工作效率更高。

### 主要技术指标：



主轴	转速	3000~40000rpm
	输出功率	0.75kW
X 轴	有效行程	Max230mm
	切割速度	0.1~300mm/s
	返回速度	Max300mm/s
Y 轴	有效行程	Max160mm
	步进设定范围	0.001~154mm
	单步步进精度	0.003mm
Z 轴	有效行程	Max20mm
	最小步进设定	0.001mm
$\theta$ 轴	转角范围	Max260°
	重复定位精度	±20"
显微镜	单物镜摄像	
	放大倍率	100X
监视器	17 英寸纯平 CRT	
工件尺寸	2~6 英寸	
应用刀片	Φ50.8mm~Φ56mm	
安装	体积 (W×D×H)	500×965×1560 (mm)
	重量	500kg
	电源	AC 220V±10%，三相

HP-600S 型精密自动划片机：增配划切箱、 $\theta$  工作台、控制划切模式，能够增大划切尺寸（156mm\*156mm），更适合太阳能行业使用。